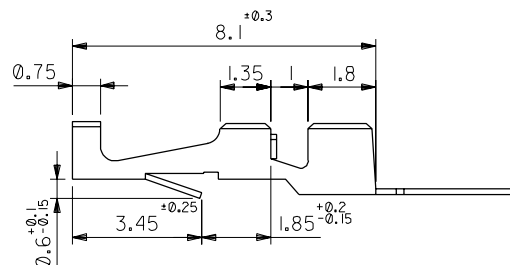


\ トレードマーク
 TRADE MARK



1. プリント基板推奨穴径: $\varnothing 1.24^{+0.08}$
RECOMMENDED PCB HOLE DIMENSION: $\varnothing 1.24^{+0.08}$

2. プリント基板推奨板厚: $1.57^{+0.2}$
RECOMMENDED PCB THICKNESS: $1.57^{+0.2}$

08-70-0060	5190-0IT	連鎖状
EDP NO.	ENG NO.	形状

						材料 MATERIAL 銅メッキ済み黄銅 BRASS, PRE-TINNED PLATED		 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
						仕上げ FINISH —— //		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
角度 ANGLE		+3°				通用電線範囲 WIRE RANGE AWG #22~#26		TITLE 名称	
30°以上 OVER		+0.3				被覆外径 INS. RANGE Ø(1.3)~1.7		PCB CRIMP PIN	
10°以上 30°未満 OVER UNDER		+0.25				DRAWN BY '96/7/29 M.ASAOKA		CHK'D BY '96/7/29 M.FUKUSHIMA	
10°未満 UNDER		+0.2		J REDRAWN (JC70322)		DATE '96/7/29		DWG. NO.	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 CTR		変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK. DATE		AP'D BY '96/7/29 M.ENOMOTO	
								尺度 SCALE 8 : 1	
								SD-5190-01*	
								REV J	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 FN-01C(0

EN-0 IC(032)MXJ-32